

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一九年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2019年11月12日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一九年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一九年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.39 億美元，同比下降 0.9%，環比增長 3.9%。
- 毛利率 31.0%，同比下降 3.0 個百分點，環比持平。
- 期內溢利 4,440 萬美元，同比下降 12.8%，環比下降 11.0%。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,520 萬美元，同比下降 6.4%，環比上升 4.3%。
- 基本每股盈利 0.035 美元，同比下降 0.011 美元，環比上升 0.001 美元。
- 淨資產收益率（年化）8.4%。

二零一九年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.42 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 26%到 28%之間。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事唐均君先生，對第三季度的業績評論道：

“儘管上季度經濟環境存在挑戰和不確定性，華虹半導體仍精准貫徹落實戰略部署、推動業績持續增長。第三季度我們的銷售收入達 2.39 億美元，環比增長 3.9%，同比基本持平。收入方面的強勁表現主要得益於中國和亞洲其他國家及地區對我們產品需求的增加，尤其是 MCU、超級結、IGBT、通用 MOSFET、電源管理芯片和模擬產品。這再次凸顯了我們特色工藝產品的實力和質量。面對不盡理想的市場環境，公司迎難而上、交出了一份亮眼的成績單。毛利率維持在 31%，取得這一業績並非一蹴而就。總體而言，市場變化使產品面臨價格下行壓力，與此同時硅片成本卻顯著上升。這些不利因素被整體產能利用率上升至 96.5% 所抵消。此外，上季度收到的大量政府補貼，抵消了部分折舊成本。”

“華虹無錫 300mm 晶圓廠（七廠）本季度開始投入生產。公司團隊已經在七廠產線上驗證通過了若干個客戶的產品，其中有兩個產品，良品率已達到 90%。作為整體擴產計劃的一部分，該晶圓廠將在未來幾年裡為我們提供巨大的發展機會。管理團隊深知在最短時間內使該晶圓廠實現盈利的重要性和緊迫性，這無疑將是我們下階段的工作重點。”

“對公司的發展方向和戰略方針，我們仍保持非常積極樂觀的看法。我們相信 5G 將成為下一個浪潮，為半導體企業帶來新的機遇。對半導體器件的需求會相應激增，包括微控制器、傳感器、射頻、電源管理和存儲器。作為特色工藝的領先者，華虹半導體將在 5G 創新中扮演不可或缺的重要角色。”

電話會議公告

日期： 二零一九年十一月十三日（星期三）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2019 年 11 月 13 日，星期三）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~q3_2019_earnings_call

電話詳細：

国际	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 9372033

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。（回放密碼：Huahong）

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17.5 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	238,993	241,222	230,037	(0.9)%	3.9 %
銷售成本	(164,981)	(159,276)	(158,614)	3.6 %	4.0 %
毛利	74,012	81,946	71,423	(9.7)%	3.6 %
毛利率	31.0 %	34.0 %	31.0 %	(3.0)	-
經營開支	(40,184)	(31,798)	(35,352)	26.4 %	13.7 %
其他收入淨額	23,517	14,320	24,616	64.2 %	(4.5)%
稅前溢利	57,345	64,468	60,687	(11.0)%	(5.5)%
所得稅開支	(12,924)	(13,547)	(10,793)	(4.6)%	19.7 %
期內溢利	44,421	50,921	49,894	(12.8)%	(11.0)%
淨利潤率	18.6 %	21.1 %	21.7 %	(2.5)	(3.1)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	45,225	48,300	43,360	(6.4)%	4.3 %
非控股權益	(804)	2,621	6,534	(130.7)%	(112.3)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.035	0.046	0.034	(23.9)%	2.9 %
攤薄	0.035	0.046	0.033	(23.9)%	6.1 %
付運晶圓(仟片)	524	530	489	(1.1)%	7.2 %
產能利用率 ¹	96.5 %	101.5 %	93.2 %	(5.0)	3.3
淨資產收益率 ²	8.4 %	11.2 %	8.0 %	(2.8)	0.4

二零一九年第三季度

- 銷售收入 2.39 億美元，同比下降 0.9%，環比增長 3.9%。
- 銷售成本 1.65 億美元，同比上升 3.6%，主要由於原材料單位成本上升；環比上升 4.0%，主要由於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 31.0%，同比下降 3.0 個百分點，主要由於產能利用率降低及原材料單位成本上升；環比持平。
- 經營開支 4,020 萬美元，同比上升 26.4%，環比上升 13.7%，主要由於華虹無錫的人工費用和研發工程片成本上升。
- 其他收入淨額 2,350 萬美元，同比上升 64.2%，主要受益於以下收益的增加(i)政府補貼，(ii)匯兌收益，(iii)分佔一家聯營公司溢利；環比下降 4.5%，主要由於以下收益的減少(i)匯兌收益，(ii)利息收入，及(iii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，部分被以下收益的增加所抵消(i)政府補貼，及(ii)分佔一家聯營公司溢利。
- 所得稅開支 1,290 萬美元，同比下降 4.6%，主要由於應課稅利潤減少。
- 期內溢利 4,440 萬美元，同比下降 12.8%，環比下降 11.0%。
- 淨利潤率 18.6%，同比下降 2.5 個百分點，環比下降 3.1 個百分點。
- 基本每股盈利 0.035 美元，同比下降 0.011 美元，環比上升 0.001 美元。
- 淨資產收益率(年化) 8.4%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	233,006	97.5 %	236,125	97.9 %	(3,119)	(1.3)%
其他	5,987	2.5 %	5,097	2.1 %	890	17.5 %
銷售收入總額	238,993	100.0 %	241,222	100.0 %	(2,229)	(0.9)%

- 本季度 97.5% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	148,649	62.2 %	137,615	57.1 %	11,034	8.0 %
美國	35,328	14.8 %	40,109	16.6 %	(4,781)	(11.9)%
亞洲 ⁴	29,648	12.4 %	30,655	12.7 %	(1,007)	(3.3)%
歐洲	17,292	7.2 %	18,607	7.7 %	(1,315)	(7.1)%
日本 ⁵	8,076	3.4 %	14,236	5.9 %	(6,160)	(43.3)%
銷售收入總額	238,993	100.0 %	241,222	100.0 %	(2,229)	(0.9)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.486 億美元，占銷售收入總額的 62.2%，同比增長 8.0%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 3,530 萬美元，同比減少 11.9%，主要由於通用 MOSFET 和閃存產品的需求減少。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,960 萬美元，同比減少 3.3%，主要由於邏輯產品的需求減少，部分被 MCU 和通用 MOSFET 產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,730 萬美元，同比減少 7.1%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 810 萬美元，同比減少 43.3%，主要由於一個客戶需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	88,198	36.2 %	89,571	37.1 %	(1,373)	(1.5)%
分立器件	90,283	39.1 %	81,432	33.8 %	8,851	10.9 %
模擬與電源管理	36,506	13.5 %	37,813	15.7 %	(1,307)	(3.5)%
邏輯及射頻	22,000	9.8 %	26,052	10.8 %	(4,052)	(15.6)%
獨立非易失性存儲器	1,750	1.3 %	6,268	2.6 %	(4,518)	(72.1)%
其他	256	0.1 %	86	-	170	197.7 %
銷售收入總額	238,993	100.0 %	241,222	100.0 %	(2,229)	(0.9)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,820 萬美元，同比減少 1.5%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 9,030 萬美元，同比增長 10.9%，主要得益於超級結和 IGBT 產品的需求增加，部分被通用 MOSFET 產品的需求減少所抵消。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,650 萬美元，同比減少 3.5%，主要由於 LED 照明產品的需求減少，部分被模擬產品的需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,200 萬美元，同比減少 15.6%，主要由於邏輯產品的需求減少，部分被射頻產品的需求增加所抵消。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 180 萬美元，同比減少 72.1%，主要由於閃存和 EEPROM 產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 μ m 及以下	80,914	33.9 %	82,458	34.2 %	(1,544)	(1.9)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	35,893	15.0 %	35,178	14.6 %	715	2.0 %
0.25 μ m	3,249	1.4 %	3,790	1.6 %	(541)	(14.3)%
0.35 μ m 及以上	118,937	49.7 %	119,796	49.6 %	(859)	(0.7)%
銷售收入總額	238,993	100.0 %	241,222	100.0 %	(2,229)	(0.9)%

- 本季度 0.13 μ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,090 萬美元，同比減少 1.9%，主要由於智能卡芯片及邏輯產品的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,590 萬美元，同比增長 2.0%，主要得益於模擬產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 320 萬美元，同比減少 14.3%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.189 億美元，同比減少 0.7%，主要由於智能卡芯片、LED 照明及通用 MOSFET 產品的需求減少，部分被超級結產品的需求增加所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一九年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第三季度 % (未經審核)	二零一八年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	145,954	61.1 %	156,590	64.9 %	(10,636)	(6.8)%
工業及汽車	60,248	25.2 %	48,497	20.1 %	11,751	24.2 %
通訊	23,609	9.9 %	24,587	10.2 %	(978)	(4.0)%
計算機	9,182	3.8 %	11,548	4.8 %	(2,366)	(20.5)%
銷售收入總額	238,993	100.0 %	241,222	100.0 %	(2,229)	(0.9)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.46 億美元，占銷售收入總額的 61.1%，同比減少 6.8%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 6,020 萬美元，同比增長 24.2%，主要得益於 MCU、超級結、通用 MOSFET 及射頻產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,360 萬美元，同比減少 4.0%，主要由於邏輯產品的需求減少，部分被智能卡芯片的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 920 萬美元，同比減少 20.5%，主要由於閃存和通用 MOSFET 產品的需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	65	65
2 號晶圓廠	60	59	60
3 號晶圓廠	50	48	50
合計	175	172	175
產能利用率	96.5%	101.5%	93.2%

- 本季度末月產能為 175,000 片，本季度產能利用率為 96.5%。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	524	530	489	(1.1)%	7.2%

- 本季度付運晶圓 524,000 片，同比減少 1.1%，環比增加 7.2%。

經營開支分析

以千美元計	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,925	2,025	1,979	(4.9)%	(2.7)%
管理費用 ⁷	38,259	29,773	33,373	28.5 %	14.6 %
經營開支	40,184	31,798	35,352	26.4 %	13.7 %

- 經營開支 4,020 萬美元，同比上升 26.4%，環比上升 13.7%，主要由於華虹無錫的人工費用和研發工程片成本上升。

其他收入淨額

以千美元計	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,142	3,253	3,225	(3.4)%	(2.6)%
利息收入	3,479	1,356	5,661	156.6 %	(38.5)%
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產之公允價值變動收益	5,713	7,196	7,627	(20.6)%	(25.1)%
匯兌收益	3,881	1,086	7,589	257.4 %	(48.9)%
分佔一家聯營公司溢利	2,720	453	627	500.4 %	333.8 %
財務費用	(294)	(487)	(309)	(39.6)%	(4.9)%
政府補貼	4,685	979	82	378.5 %	5,613.4 %
其他	191	484	114	(60.5)%	67.5 %
其他收入淨額	23,517	14,320	24,616	64.2 %	(4.5)%

- 其他收入淨額 2,350 萬美元，同比上升 64.2%，主要受益於以下收益的增加(i)政府補貼，(ii)匯兌收益，(iii)分佔一家聯營公司溢利；環比下降 4.5%，主要由於以下收益的減少(i)匯兌收益，(ii)利息收入，及(iii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，部分被以下收益的增加所抵消(i)政府補貼，及(ii)分佔一家聯營公司溢利。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一八年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	70,682	72,969	20,659	(3.1)%	242.1 %
投資活動所用現金流量淨額	(421,707)	(600,214)	(280,795)	(29.7)%	50.2 %
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(171)	140	(52,974)	(222.1)%	(99.7)%
外匯匯率變動影響淨額	(8,812)	(25,337)	(7,471)	(65.2)%	17.9 %
現金及現金等價物變動影響淨額	(360,008)	(552,442)	(320,581)	(34.8)%	12.3 %

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 7,070 萬美元，同比下降 3.1%，但是環比上升 242.1%，主要由於上季度支付 2018 年度企業所得稅，及本季度政府補貼收款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 4.217 億美元，其中設備及無形資產投資支出 4.598 億美元，部分被(i)贖回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 3,540 萬美元，及(ii)利息收入 270 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 20 萬美元，其中包括(i)租賃負債支出 10 萬美元，及(ii)支付利息 10 萬美元。

資本結構

以千美元計	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)
資產總額	3,576,458	3,544,900
負債總額	556,098	485,546
所有者權益總額	3,020,360	3,059,354
資產負債率 ⁸	15.5%	13.7%

資本開支

以千美元計	二零一九年 第三季度 (未經審核)	二零一九年 第二季度 (未經審核)
華虹宏力	32,320	40,692
華虹無錫	427,485	182,361
合計	459,805	223,053

- 本季度資本開支 4.598 億美元，其中 4.275 億美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)
存貨	133,117	139,128
貿易應收款項及應收票據	140,398	147,771
預付款項、按金及其他應收款項	103,889	72,067
應收關聯方款項	6,152	4,366
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	611,632	658,306
已凍結存款及定期存款	765	14,724
現金及現金等價物	474,670	834,678
流動資產總額	1,470,623	1,871,040
貿易應付款項	81,675	76,966
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	301,966	267,047
計息銀行借款	4,242	4,364
租賃負債	1,357	1,381
政府補助	76,497	55,335
應付關聯方款項	10,509	12,688
應付所得稅	27,461	18,908
流動負債總額	503,707	436,689
淨營運資金	966,916	1,434,351
速動比率	2.7x	4.0x
流動比率	2.9x	4.3x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	55	61
存貨周轉天數	74	79

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 7,210 萬美元上升至本季度末的 1.039 億美元，主要由於待抵扣進項稅的增加，部分被供應商的預付款減少所抵消。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 1,470 萬美元下降至本季度末的 80 萬美元，主要由於本季度支付了股息。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 2.67 億美元上升至本季度末的 3.02 億美元，主要由於應付資本開支增加，部分被應付股息減少所抵消。
- 政府補助由上季度末的 5,530 萬美元上升至本季度末的 7,650 萬美元，主要由於收到政府補助項。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,270 萬美元下降至本季度末的 1,050 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 1,890 萬美元上升至本季度末的 2,750 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支。
- 本季度末淨營運資金 9.669 億美元，流動比率 2.9。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 55 天
- 本季度末存貨周轉天數 74 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)
銷售收入	238,993	241,222	230,037
銷售成本	(164,981)	(159,276)	(158,614)
毛利	74,012	81,946	71,423
其他收入及收益	21,117	14,354	24,302
銷售及分銷費用	(1,925)	(2,025)	(1,979)
管理費用	(38,259)	(29,773)	(33,373)
其他費用	(26)	-	(4)
財務費用	(294)	(487)	(309)
分佔一家聯營公司溢利	2,720	453	627
稅前溢利	57,345	64,468	60,687
所得稅開支	(12,924)	(13,547)	(10,793)
期內溢利	44,421	50,921	49,894
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	45,225	48,300	43,360
非控股權益	(804)	2,621	6,534
持有人應佔每股盈利			
基本	0.035	0.046	0.034
攤薄	0.035	0.046	0.033
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,285,596,506	1,040,919,943	1,285,237,562
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,293,558,506	1,054,748,943	1,299,346,562

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	1,563,446	1,037,724	751,971
使用權資產	16,051	16,914	-
投資物業	166,148	170,939	170,579
預付土地租賃款項	57,396	58,570	59,012
無形資產	11,715	12,198	5,877
於聯營公司的投資	65,805	64,900	60,015
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	202,179	208,008	207,925
長期預付款項	8,376	90,270	3,466
應收關聯方款項	6,714	6,908	-
遞延稅項資產	8,005	7,429	7,111
非流動資產總額	2,105,835	1,673,860	1,265,956
流動資產			
存貨	133,117	139,128	132,924
貿易應收款項及應收票據	140,398	147,771	124,932
預付款項、按金及其他應收款項	103,889	72,067	7,185
應收關聯方款項	6,152	4,366	50,228
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	611,632	658,306	775,311
已凍結存款及定期存款	765	14,724	340
現金及現金等價物	474,670	834,678	284,280
流動資產總額	1,470,623	1,871,040	1,375,200
流動負債			
貿易應付款項	81,675	76,966	68,632
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	301,966	267,047	140,159
計息銀行借款	4,242	4,364	60,521
租賃負債	1,357	1,381	-
政府補助	76,497	55,335	43,722
應付關聯方款項	10,509	12,688	14,868
應付所得稅	27,461	18,908	27,015
流動負債總額	503,707	436,689	354,917
流動資產淨額	966,916	1,434,351	1,020,283
總資產減流動負債	3,072,751	3,108,211	2,286,239
非流動負債			
計息銀行借款	23,328	24,001	28,346
租賃負債	16,258	16,653	-
遞延稅項負債	12,805	8,203	13,096
非流動負債總額	52,391	48,857	41,442
淨資產	3,020,360	3,059,354	2,244,797
權益和負債權益			
股本	1,963,245	1,961,742	1,559,054
儲備	219,213	234,763	147,552
本公司擁有人應佔權益	2,182,458	2,196,505	1,706,606
非控股權益	837,902	862,849	538,191
權益總額	3,020,360	3,059,354	2,244,797

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一八年 (未經審核)	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	57,345	64,468	60,687
折舊及攤銷	25,814	30,429	32,610
應佔聯營公司溢利	(2,720)	(453)	(627)
營運資金的變動及其它	(9,757)	(21,475)	(72,011)
經營活動所得現金流量淨額	70,682	72,969	20,659
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(459,805)	(62,027)	(223,053)
其他投資活動所得/(用)現金流量	38,098	(538,187)	(57,742)
投資活動所用現金流量	(421,707)	(600,214)	(280,795)
融資活動所(用)/得現金流量：			
發行股份所得收益	29	627	537
向股東支付股息	(13,921)	(13,851)	(37,042)
已凍結存款的減少/(增加)	13,921	13,851	(13,943)
償還銀行貸款	-	-	(2,182)
償還租賃負債	(114)	-	(249)
已付利息	(86)	(487)	(95)
融資活動所(用)/得現金流量	(171)	140	(52,974)
現金及現金等價物減少淨額	(351,196)	(527,105)	(313,110)
外匯匯率變動影響淨額	(8,812)	(25,337)	(7,471)
期初現金及現金等價物	834,678	836,722	1,155,259
期末現金及現金等價物	474,670	284,280	834,678

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

杜洋
森田隆之
王靖
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司
張素心
董事長兼執行董事

中國 香港
二零一九年十一月十二日